

# レーザー モールド樹脂パリ取り装置 AU112

AU112

2008.12.24

綜和機電株式会社

フレーム状態のディスプレイ IC デバイスの樹脂パリを レーザーで切り落とすための装置  
特に微小デバイスに対して 精度よく また、効果的にパリをとるため 2台のレーザー発振器  
を設備して 加工しています。  
2台のレーザー間には ライナーを抜き落とすための金型も用意されています。

## AU112



SOWA Mechatronics Corp.

加工精度 30  $\mu$  レーザー発振器加工精度 10  $\mu$  を含む

供給 搬送

スタックマガジン内から取り出されたフレームを 搬送テーブルに乗せて 加工します。

加工工程

第1 レーザー加工

Y方向切断

モールド注入ゲート(サブライナー)を切断

ライナー抜き落とし用金型

第1 レーザー加工で切断したサブライナーを抜き落とします。

第2 レーザー加工

X方向切断

リード付け根のダムパリを切り落とします。

後工程へ受け渡し または マガジンへ収納

処理能力 6\*90マトリックス のフレームで 0.13sec/1デバイス……70sec/1フレーム

